

一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム  
平成29年度第3回研究会  
プログラム

日時： 平成30年3月2日（金）研究会 13:30-16:50  
懇親会 17:00-

場所： 東京工業大学 大岡山キャンパス石川台3号館  
(〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1)  
研究会： 304号室、 懇親会： 305号室

テーマ：「研削におけるナノ精度加工の最前線」

プログラム

- 13:30~14:15 (1) 次世代半導体の高能率ダメージレス研削  
(株)アライドマテリアル 石津 智広 氏
- 14:15~15:00 (2) 導電性ダイヤモンド工具を利用した精密研削加工  
富山県立大学 岩井 学 氏
- 15:00~15:20 休 憩
- 15:20~16:05 (3) 超精密加工機と加工事例  
東芝機械(株) 福田 将彦 氏
- 16:05~16:50 (4) ELID 研削における最新情報  
理化学研究所 大森 整 氏
- 17:00~ 懇親会

FAX : 050-3156-2920

(社)ニューダイヤモンドフォーラム事務局行

一般社団法人ニューダイヤモンドフォーラム  
平成29年度第3回研究会  
参加申込書

平成 年 月 日

参加申込〆切 : 平成30年2月23日 (金)

平成30年3月2日 (金) 13時30分開催

1) 研究会 ( 出席 欠席 )

2) 懇親会 ( 出席 欠席 )

なお、懇親会に関して

(1) 領収書が必要な方は事前にご連絡下さい。

(2) 懇親会参加申込後のキャンセルはできませんのでご留意下さい。

会員資格に○をつけて下さい。

1. フォーラム会員

2. 会員外 ( 企業 研究機関/大学 )

御氏名 : \_\_\_\_\_

御所属 : \_\_\_\_\_

TEL : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

連絡事項 :